

2024-2030年中国半导体封装用引线框架市场研究 分析及投资前景评估报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202110/977805.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

由智研咨询专家团队精心编制的《2024-2030年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手，分析半导体封装用引线框架行业未来的市场走向，挖掘半导体封装用引线框架行业的发展潜力，预测半导体封装用引线框架行业的发展前景，助力半导体封装用引线框架业的高质量发展。

本《报告》从2022年全国半导体封装用引线框架行业发展环境、全球发展态势、行业规模、竞争格局、重点企业等角度进行入手，系统、客观的对我国半导体封装用引线框架行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国半导体封装用引线框架行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国半导体封装用引线框架行业发展状况的著作，对于全面了解中国半导体封装用引线框架行业的发展状况、开展与半导体封装用引线框架行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事半导体封装用引线框架行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。

引线框架是一种用来作为集成电路芯片的金属结构载体。引线框架是借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路的关键结构件，引线框架是电子信息产业中重要的IC封装材料，在电路中发挥着重要作用：包括连接外部电路和传递电信号作用；向外界散热，发挥导热作用；支撑和固定芯片的作用，其外壳整体支撑框架结构通过IC组装而成，保护内部元器件。根据生产工艺不同，引线框架分为冲压型和蚀刻型两种，蚀刻型工艺，主要用于100脚位以上的引线框架，环保压力和设备成本等较大，国内目前主要以冲压工艺为主。。

国内整体引线框架市场规模情况而言，虽然目前国产引线框架水平叫国际先进水平仍存在部分差距，但在国产化替代需求背景下，国内整体半导体材料增速明显高于全球领域，半导体引线框架市场规模也略高于全球增速，数据显示我国引线框架市场规模从2016年的81亿元左右增长至2021年的105.8亿元，2022年整体下游影响市场规模增长至114.8亿元，细分规模来看，国产企业销售规模快速增长，2022年已达65.53亿元，随着国内整体半导体国产化替代需求持续推动，我国引线框架市场规模将持续向好。

目前高端的蚀刻引线框架主要依靠进口，在中美半导体贸易摩擦和国家对集成电路行业大力扶持的政策下，高端封装材料国产替代势在必行。境内的蚀刻引线框架起步较晚，目前只有康强电子、新恒汇、天水华洋等少数企业涉足，但是产能较小，市场基本被境外厂商垄断，未来国产替代空间广阔。康强电子经营现状而言，2022年整体宏观关键变化，下游消费电子、通信需求放缓，康强电子引线框架整体业务收到较大影响，数据显示，2022年康强电子框架产销量分别为1154.3亿只和1142.9亿只，引线框架营收规模为9.02，较2021年的13.

16亿元下降明显，产品单价从2021年的79.23元/万只略微下降至2022年的78.92元/万只。

引线框架作为半导体封装产业链中的关键一环，技术上仍保持着持续不断地进步，“小型化”发展趋势，对封装要求更小、更轻、更薄，反映到引线框架材料上，要求材料厚度减薄、精度提高此外，良好的导电性和一系列加工特性也是必备要求。目前高强高导型引线框架材料已逐步成为市场主流，理想上优良的引线框架材料强度应大于600MPa、硬度HV应大于130、电导率(IACS)应大于80%。

蚀刻引线框架采用腐蚀液对铜带材腐蚀成型，产品精度较高，可生产多脚位产品，符合集成电路小型化、轻薄化、高速化的发展趋势，有望成为行业主流。蚀刻型引线框架用铜合金带材除了要满足冲制型引线框架带材的所有技术指标外，对带材产品的板形、残余应力、表面缺陷等均提出了更高的要求，基本代表了引线框架带材加工的最高技术水平。

《2024-2030年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报告》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是半导体封装用引线框架领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

报告目录：

第一章 引线框架产品概述

1.1 引线框架概述

1.1.1 定义

1.1.2 引线框架在半导体封装中的应用

1.1.3 引线框架产品形态

1.1.4 引线框架产品特性与各功能结构

1.2 引线框架的发展历程

1.2.1 引线框架随着半导体封装技术发展而得到发展

1.2.2 当今及未来引线框架技术发展路线图

1.2.3 引线框架主流铜带材料的转变

1.3 引线框架在半导体产业发展中的重要地位

1.3.1 引线框架是适合半导体键合内引线连接的关键结构材料

1.3.2 引线框架在半导体封装中所担负的重要功效

1.3.3 引线框架在半导体封装的性能提高、成本控制上发挥着重要作用

第二章 引线框架产品品种、分类及性能要求

2.1 引线框架主流产品品种的演变

2.2 引线框架的品种分类

2.2.1 按照材料组成成分分类

2.2.2 按照生产工艺方式分类

2.2.3 按材料性能分类

2.2.4 按照使用的不同器件类别分类

2.3 引线框架材料的性能要求

2.3.1 对引线框架材料的性能要求

2.3.2 封装工艺对引线框架的性能要求

2.4 引线框架的国内外相关标准

2.4.1 国内相关标准

2.4.2 国外相关标准

第三章 引线框架的生产制造技术现况

3.1 引线框架成形加工两类工艺方式

3.2 冲制法生产引线框架

3.2.1 冲制法生产引线框架的工艺特点

3.2.2 冲制法的关键技术

3.3 蚀刻法生产引线框架

3.3.1 蚀刻法生产引线框架的工艺原理及过程

3.3.2 与冲制法相比的优点

3.4 引线框架表面电镀处理

3.4.1 引线框架表面电镀层的作用与特点

3.4.2 引线框架电镀的工艺流程及工艺条件

3.4.3 引线框架表面电镀加工生产线的类别

3.4.4 引线框架表面电镀加工工艺的发展

3.4.5 局部点镀技术

3.4.6 SN系无铅可焊性镀层

3.4.7 PPF引线框架技术

3.4.8 国内厂家开发高性能引线框架的电镀技术创新例

第四章 世界引线框架市场需求现状与分析

4.1 世界引线框架市场规模

4.2 世界引线框架产品结构的变化

4.3 世界引线框架市场格局

4.4 世界引线框架市场发展及预测

4.4.1 世界半导体产业发展现况

4.4.2 世界封测产业及市场现况

4.4.3 世界引线框市场发展前景

第五章 世界引线框架生产现况

5.1 世界引线框架生产总况

5.2 世界引线框架主要生产企业的市场份额情况

5.3 世界引线框架主要生产企业的情况

5.3.1 住友金属矿山公司

5.3.2 日本三井高科技股份公司

5.3.3 台湾顺德工业股份公司

5.3.4 日本新光电气工业公司

5.3.5 日本日立高新技术有限公司

5.3.6 大日本印刷公司

5.3.7 DIC

5.3.8 韩国丰山集团

5.3.9 宁波康强电子股份有限公司

5.3.10 先进半导体物料科技有限公司

第六章 我国国内引线框架市场需求现状

6.1 我国国内引线框架市场需求总述

6.1.1 国内引线框架市场规模

6.1.2 国内引线框架市场总体发展趋势

6.1.3 国内引线框架市场的品种结构

6.2 国内引线框架的集成电路封装市场情况及发展

6.2.1 我国集成电路产业发展现况与展望

6.2.2 国内引线框架重要市场之——集成电路封装产业现况及发展

6.3 国内引线框架的分立器件市场情况及发展

6.3.1 国内分立器件产销情况

6.3.2 国内分立器件的市场情况

6.3.3 国内分立器件封装行业现况

6.4 国内引线框架的LED封装市场情况及发展

6.4.1 引线框架的LED封装上的应用

6.4.2 国内LED封装用引线框架行业情况

6.4.3 国内LED封装产业发展现况与展望

第七章 我国国内引线框架行业及主要企业现况

7.1 国内引线框架产销情况

7.2 国内引线框架生产企业总况

7.3 近几年在国内引线框架企业的投建或扩产情况

7.4 当前国内引线框架行业发展的特点与存在问题

7.5 国内引线框架主要生产企业情况

7.5.1 深圳先进微电子科技有限公司

7.5.2 泰州友润电子科技股份有限公司

7.5.5 宁波康强电子股份有限公司

7.5.4 铜陵蓝盾丰山微电子有限公司

7.5.5 三井高科技（上海）有限公司

7.5.6 中山复盛机电有限公司

7.5.7 厦门永红科技有限公司

7.5.8 无锡华晶利达电子有限公司

7.5.9 广州丰江微电子有限公司

7.5.10 济南晶恒精密电子有限公司

第八章 引线框架材料市场及其生产现况

8.1 国内外引线框架制造业对铜带材料的性能需求

8.1.1 对引线框架材料的主要性能要求

8.1.2 引线框架材料市场在品种需求上的发展变化

8.2 引线框架材料的品种、规格及基本特性

8.2.1 引线框架材料的品种

8.2.2 引线框架制造中常用的铜合金材料品种

8.3 引线框架业对铜合金材料品种需求市场的情况

8.4 引线框架业对铜合金材料需求量的情况

第九章 国内外引线框架用铜合金带材生产技术的发展及主要生产厂家的

9.1 高性能引线框架铜合金材料生产技术

9.1.1 铜合金的熔铸技术

9.1.2 铜带的加工技术

9.2 高性能引线框架铜合金材料生产工艺与设备条件

- 9.2.1 工艺技术方面
- 9.2.2 设备条件
- 9.2.3 国外工业发达国家工艺技术与装备情况
- 9.2.4 C19400的工艺流程与技术环节要点
- 9.2.5 获得高强度高导电铜合金的工艺途径
- 9.3 国外引线框架用铜带的主要生产厂商情况
- 9.4 国内引线框架用铜带的主要生产厂商情况
 - 9.4.1 我国铜及铜合金板带材的生产与需求情况
 - 9.4.2 我国引线框架用铜合金带材技术开发的情况
 - 9.4.3 我国引线框架用铜合金带材生产总况
 - 9.4.4 我国引线框架用铜合金带材主要生产厂情况

第十章 关于金属层状复合材料在引线框架领域应用前景的调查与分析

- 10.1 金属层状复合带材及其在国内的研发情况
- 10.2 金属层状复合材料的引线框架领域应用前景的调查与分析
 - 10.2.1 金属层状复合材料在引线框架领域应用的可行性
 - 10.2.2 对国外同类产品及其应用的调查
 - 10.2.3 对金属层状复合材料的引线框架领域应用前景调查
 - 10.2.4 对金属层状复合材料的引线框架领域市场情况的分析

图表目录：

- 图表：半导体封装用引线框架行业特点
 - 图表：半导体封装用引线框架行业技术分类
 - 图表：半导体封装用引线框架行业产业链分析
 - 图表：2019-2023年全球半导体封装用引线框架行业市场规模分析
 - 图表：2024-2030年全球半导体封装用引线框架行业市场规模预测
 - 图表：2019-2023年中国半导体封装用引线框架行业市场规模分析
 - 图表：2024-2030年中国半导体封装用引线框架行业市场规模预测
 - 图表：2019-2023年我国引线框架产量情况
 - 图表：2019-2023年我国引线框架销量情况
 - 图表：2024-2030年我国引线框架产销预测
- 更多图表见正文...

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202110/977805.html>